

		DRILL C	51 DRC OK	
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
0	0.200 mm		409	
۵	0.900 mm		4	
+	1.100 mm		9	
♦	1.200 mm		22	
⊠	1.300 mm		3	NON-PLATED
⊞	1.600 mm		2	
ъ	3.200 mm		5	NON-PLATED
TOTAL			454	

22-304-1.SPT 22-304-1.SST 22-304-1.SMT 22-304-1.SMT 22-304-1.GND 22-304-1.IN1 22-304-1.BOT 22-304-1.SMB

MATERIALE TIPOLOGIA CIRCUITO SUPPORTO SPESSORE RAME ☐ MONOFACCIA ☐ FR2 X LATI ESTERNI X FR4 DOPPIA FACCIA LATI INTERNI **M**MULTISTRATO SPESSORE SUPPORTO ALTRO N°LAYERS 4 1.6 mm TRATTAMENTI RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u ☐PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u ☐PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u RAME PASSIVATO MHOT AIR LEVELING \square DORATURA(D=140± \vee PN) □0.3u □0.6u □1,0u □1,3u □2,0u

NUMERO DEI CONTATTI

NUMERO DEI CONTATTI

☐LATO SALD. COLORE

SERIGRAFIA

XLATO COMP.COLORE BIANCO

BISELLATURA

DEPOSITO DI GRAFITE

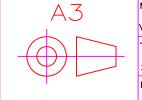
SOLDER RESIST

XFOTOGRAFICO Sp. 13-100u

□COVER LAYERSp. 25-76u

SERIGRAFICO Sp.

TABELLA DEI FORI CON LAVORAZ. PARTICOLARI				FILES DI DOCUMENTAZIONE ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE		
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	X 22-304-1.BOT	
Α				LAYER TOP	X 22-304-1.TOP	
В				LAYER PWR		
С				LAYER GND	X 22-304-1.GND	
D				SERIG. BOT	☐ 22-304-1.SSB	
Е		SERIG. TOP		SERIG. TOP	X 22-304-1SST	
F				LAYER IN1	X 22-304-1.IN1	
G				LAYER IN2		
Н				LAYER IN3		
ı				LAYER IN4		
L				RESIST BOT	X 22-304-1.SMB	
М				RESIST TOP	X 22-304-1.SMT	
NOTE PARTICOLARI				PAST BOT		
				PAST TOP	X 22-304-1.SPT	
				LAYER FOR.	X	
				DRILL CHART	X 22-304-1.DRD	
				DRILL TAPE	X 22-304-1.TAP	
TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO				MECC.DRW.	X F222-304-1.DW0	
ESSERE METALLIZATI						



	MATERIALE	TRATTAMENTO		METALTRONICA S.r.I.	
VEDI TABELLA TOLL.GENERALE		VEDI TABELLA DISEGNATORE DATA		TITOLO	
	±0.2	DISEGNATORE	31/5/23	FORATURA 22-	304 — 1
	NOME FILE	REVISIONE	DATA	COD.INTERNO	SCALA
	PF22-304-1.DWG		05/05/24		F.S.